패널 마운팅 베이스 - HC-MOD-K-AFS-OPE - 1408559

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (http://download.phoenixcontact.com)

HEAVYCON 플라스틱 패널 마운팅 베이스, 하나의 모듈 슬롯을 위한 모듈용, PE 마킹 없음, 스냅 잠금용

RoHS

주요 상용 데이터

패키지 단위	2 STK
최소 주문 수량	2 STK
GTIN	4 046356 619295
GTIN	4046356619295
개당 중량(패키지 제외)	25.000 g
관세율 번호	85389099
출신 국가	독일

기술 데이터

치수

높이	22.4 mm
폭	21.8 mm
길이	54 mm
조립 컷아웃 길이	37 mm
조립 컷아웃 폭	18 mm

주변 조건

하우징 보호 수준(IP)	IP65 (플러그 삽입 시)
주변 온도(작동)	-40 °C ... 85 °C

일반

색상	밝은 회색
잠금 타입	스냅 잠금용
스크류 연결	없음
하우징 소재	폴리카보네이트

패널 마운팅 베이스 - HC-MOD-K-AFS-OPE - 1408559

기술 데이터

일반

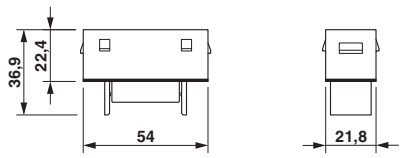
UL 94에 따른 난연성등급	V0
조립 지침	최대 50 V(PE 누락)

표준 및 규정

UL 94에 따른 난연성등급	V0

도면

치수 도면



치수 도면

인증

인증

인증

EAC

Ex 승인

승인 세부 사항

EAC	EAC	7500651.22.01.00246

액세서리

액세서리

코딩 부품

패널 마운팅 베이스 - HC-MOD-K-AFS-OPE - 1408559

액세서리

코딩 프로파일 - HC-MOD-K-CP - 1408562

HC-MOD-K... 하우징용 코딩 프로파일

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com